

■ 連結貸借対照表

科目	期別	
	当期 平成24年3月31日現在	前期 平成23年3月31日現在
資産の部		
流動資産	15,363	15,203
固定資産	5,316	5,385
有形固定資産	4,253	4,403
無形固定資産	49	43
投資その他の資産	1,013	938
資産合計	20,680	20,588
負債の部		
流動負債	733	681
固定負債	627	600
負債合計	1,361	1,281
純資産の部		
株主資本	19,857	19,824
その他の包括利益累計額	△544	△517
新株予約権	6	-
純資産合計	19,319	19,306
負債純資産合計	20,680	20,588

■ 連結損益計算書

科目	期別	
	当期 平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	前期 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで
売上高	4,781	4,779
売上総利益	1,601	1,488
販売費及び一般管理費	1,597	1,653
営業損益	3	△164
経常損益	45	△19
税金等調整前当期純損益	99	△456
当期純損益	33	△512

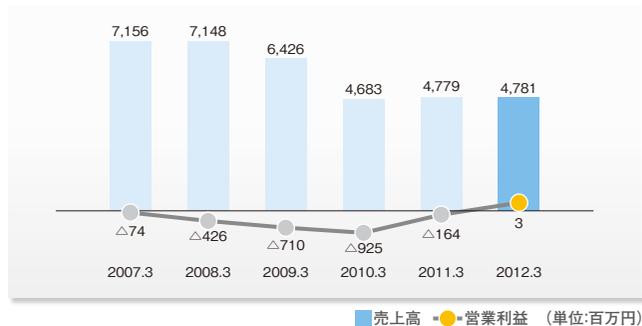
■ 連結キャッシュ・フロー計算書

科目	期別	
	当期 平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで	前期 平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	△109	△320
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38	391
財務活動によるキャッシュ・フロー	△0	△0
現金及び現金同等物の期末残高	1,459	1,624

決算のポイント

■ 営業黒字を回復

タイで発生した洪水の影響等により光通信用部品の売上高が前期から減少しましたが、スマートフォンや携帯電話に搭載するカメラ用レンズの販売が好調に推移し、当期の連結売上高はほぼ前期並みとなりました。また、前期から取り組んでいる長期経営計画『マスタープラン2010』に基づく様々な施策を通じてコスト削減に注力した結果、営業利益を回復させることができました。今後は、利益体質を維持しながら売上拡大に努め、経営基盤の一層の強化を実現してまいります。



■ 株式の状況

発行済株式総数	9,333,654株
株主数	3,832名

■ 株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
 定時株主総会 毎年6月
 基準日 毎年3月31日
 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社
 郵便物送付先 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 (電話照会先) ☎0120-782-031
 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

株式会社精工技研 広報課

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296番地の1
 TEL 047-388-6401(直通) FAX 047-388-4477
 E-mail ir@seikoh-giken.co.jp WEB http://www.seikoh-giken.co.jp

ごあいさつ

株主の皆様におかれましては、平素より当社に対しまして格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。

当期は、前期より取り組みを開始した長期経営計画『マスタープラン2010』に基づき、「事業の再構築」と「事業拡大」の施策を積極的に推進した結果、黒字を回復させることができました。

次期は、いかなる環境下でも利益を創出し、未来に向けて安定的に成長することのできる力強い企業体質を確立するべく、社員一同、一層努力してまいります。

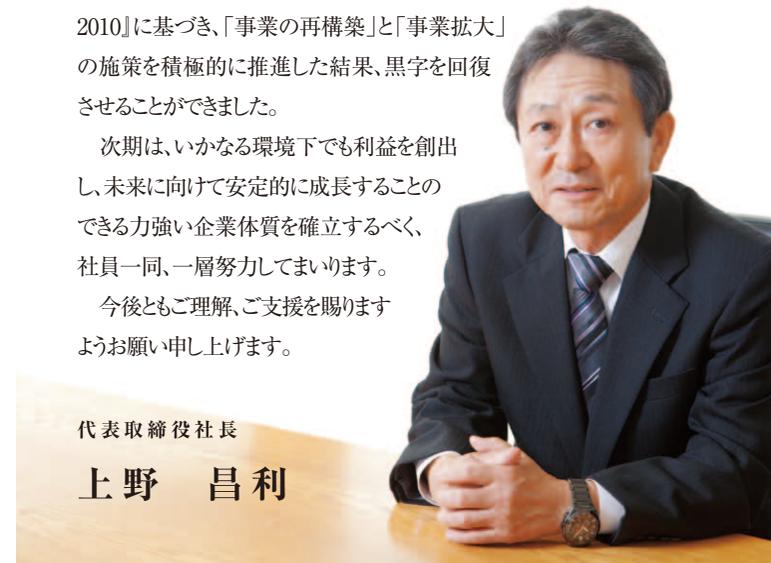
今後ともご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

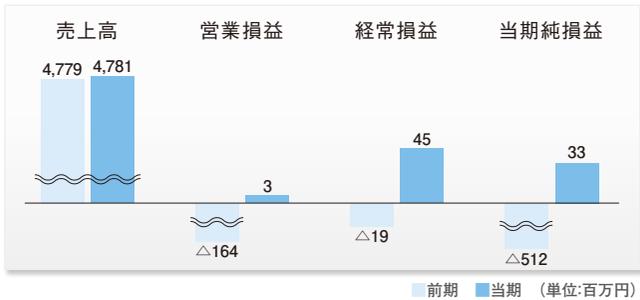
代表取締役社長

上野 昌利



株主通信
 第40期 事業報告
 平成23年4月1日～平成24年3月31日





当期、当社グループは、前期からスタートさせた長期経営計画『マスタープラン2010』の遂行に取り組みました。大幅なコストの削減を実施した前期に引き続き、計画2年目となる当期は「事業拡大」へと軸足を移し、販売力と価格競争力の強化、新事業・新製品創出のための基盤強化を行いました。

精機事業では精密金型技術・精密加工技術を活かした新たなビジネスの開拓に注力したほか、光製品事業では伸長著しい中国市場に注力しながらも、今後の発展が期待される南米等の新しい市場の開拓に努めました。また下期より社内に『現場力強化プロジェクト』を発足させ、課題の明確化と課題解決のための施策を展開し、販売力と価格競争力の強化を図りました。昨年8月には、新事業開拓を専門に行う部署を立ち上げ、当社グループの次代を担う新事業の創出に向けた活動を強化しました。

こうした諸施策を実施した結果、海外の子会社はいずれも売上高を増加させることができました。しかしながら、タイで発生した洪水に加え、円高の影響もあり、当期の連結売上高は4,781百万円と、前期とほぼ同水準に留まりました。営業損益につきましては、原価率が改善したほか、研究開発費や減価償却費等の費用も減少したことから大幅に改善し、6期ぶりに利益を計上することができました。また経常損益も前期までの赤字を脱したほか、当期純損益も多額の特別損失を計上した前期から大幅に改善することができました。

当期は利益を創出することができましたが、いまだに企業体質は脆弱であり、誠に遺憾ではありますが、株主の皆様に対する配当を見送らせていただくこととしました。次期につきましては、利益体質を確実なものとし、株主の皆様に対して利益還元を実施できるよう努めてまいります。



精機事業 超精密金型 / 精密加工

業界最高水準の金型技術と精密加工技術で、お客様の製品開発と生産性向上を支援します。



微細な溝を施した成形品



スマートフォン用レンズ

精機事業においては、光ディスク成形用金型依存からの脱却をテーマに掲げ、今後の事業収益の柱となる新しいビジネスの立ち上げに取り組みました。光ディスク成形用金型の製造技術の応用展開により、極めて薄い成形品を高精度で量産することのできる超精密金型を開発したほか、この金型を利用した薄肉成形品の開発等を行いました。高耐熱レンズについては、欧米市場に向けたスマートフォンや携帯電話に搭載するカメラレンズの本格量産が始まり、売上を拡大させることができました。これらの結果、当期の売上高は1,111百万円となりました。

光製品事業 接続部品 / 光部品 / 製造機器

光通信ネットワークの高速・大容量化を支える高精度な技術・製品を提供します。



ファイバアレイ



光コネクタ研磨機

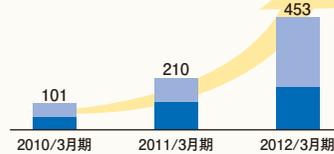
光製品事業においては、成長性の高い中国市場での受注拡大に注力いたしました。欧米においても新規顧客の開拓とシェアの拡大に努めた結果、海外子会社の売上高を伸長させることができました。一方、日本においては、タイで発生した洪水の影響で一部の部材の供給が停滞し、生産に影響が生じたこととなりました。さらに期中は円高基調で推移したことから、円換算後の連結売上高は伸び悩むこととなりました。これらの結果、当期の売上高は3,670百万円となりました。

トピックス 1

高耐熱レンズ事業の拡大

杭州精工技研は、2008年に「MSGレンズ」の生産を開始して以来、順調に売上を伸ばしています。スマートフォンへの搭載も始まり、更なる拡大に向けて自動成形機を増強。新工場も稼働を開始しています。

レンズ事業 売上高の推移
■上期 ■下期 (単位:百万円)



右上:「MSGレンズ」
左下:「MSGレンズ」の生産現場

トピックス 2

精機事業のビジネスと新しい展開

光ディスク成形用金型の需要停滞を受けて、精機事業は既存ビジネスに加えて新たな展開を開始。他社が真似のできない高い技術力で、お客様の期待に応えてまいります。



超精密金型

金型技術に低型温成形技術、薄肉成形技術等の特殊な技術を合わせ、お客様のニーズに、金型での解決策をご提供します。



光ディスク金型

ブルーレイディスク成形用金型のニーズを確実にキャッチしつつ、金型の交換部品やメンテナンス等、既存のお客様をサポートします。



射出成形

内製した金型を使用し、0.3mm程の極めて薄い製品や、微細な溝がある精密成形品、難易度の高い高精度な成形部品等の量産化を実現します。



精密研磨

次世代の半導体基板として注目されている炭化ケイ素(SiC)結晶を、歪みなく、極限まで平坦に研磨加工することが可能です。